

## 技術資料

### ● 電子材料用フリットの主な使用目的と適用できるガラス組成系の軟化温度

目的	基材/素材	軟化温度 (°C)								主な用途	
		300	400	500	600	700	800	900	1000		
低温気密封止	ガラス セラミックス 金属		Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 系								パッケージ部品
絶縁性付与 抵抗付与	セラミックス 金属		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -R <sub>2</sub> O系		Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 系		R <sub>2</sub> O-ZnO-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 系		R <sub>2</sub> O-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiO <sub>2</sub> 系		磁性体, 抵抗体, バリスター等 電子部品配線カバーコート
密着性付与 接合	セラミックス 金属粉		Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 系				RO-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiO <sub>2</sub> 系				セラミックスバインダー 各種電子部品用電極(焼付電極)
平滑性付与	セラミックス						RO-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiO <sub>2</sub> 系				グレーズド基板
低温焼結	セラミックス						RO-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiO <sub>2</sub> 系				LTCC(低温焼成セラミックス)基板

※ 上記以外の用途でも、ご要望に応じた提案をいたします。

詳細な情報やサンプルにつきましては、下記 または お問い合わせメールフォームからお問い合わせ下さい。